

檔 號： 020602
保存年限： 5
電子簽核

收發文號： 1120006001
收發日期： 112年05月25日
創稿文號： 1121296489
1121296489

明新學校財團法人明新科技大學 函

機關地址： 30401新竹縣新豐鄉新興路1號
傳 真： (03)5595142
承 辦 人： 何宗穎
聯絡電話： (03)5593142分機3270
電子郵件： zyho@must.edu.tw

受 文 者： 國立臺東專科學校

發文日期： 中華民國112年05月24日

發文字號： 明新(半)字第1120005435號

速 別： 普通件

密等及解密條件或保密期限：

附 件： (2件) 附件如說明一(54712c58bf91f74d1e31c5bcba590f92_1121200760_1_ATTCH1.pdf、54712c58bf91f74d1e31c5bcba590f92_1121200760_2_ATTCH2.pdf，共二個電子檔案) [1121296489_1_54712c58bf91f74d1e31c5bcba590f92_1121200760_1_ATTCH1.pdf](#) (附件1. 明新科技大學111學年度教師產業研習活動簡章1份)
[1121296489_2_54712c58bf91f74d1e31c5bcba590f92_1121200760_2_ATTCH2.pdf](#) (附件2. 明新科技大學111學年度教師產業研習活動海報1份)

主旨：本校辦理111學年度教師產業研習「半導體封裝製程與設備實務培訓營」第二梯次培訓課程，誠摯邀請工程專業領域之大學及高中職教師，請轉知貴屬，並踴躍報名參加，請查照。

說明：

- 一、為提升教師多元實務專長，教育部特補助本校辦理半導體封裝製程與設備實務培訓營。課程內容有半導體封裝製程及設備實務操作，並由專業學者與業師共同授課。封裝製程主要講授傳統封裝、高階封裝及先進封裝製程等專業知識；設備實務則訓練晶圓切割機、固晶機及打線機的實務操作能力；QFN自動機台操作實務則有機台介紹、製程參數設定及機台運轉測試。誠摯邀請貴校教師踴躍參加，讓本研習活動的效益能擴及其他友校。研習課程內容請詳閱活動簡章(附件1)及活動海報(附件2)各1份。

二、研習相關資訊：

(一)第二梯次研習時間：112年7月3日(星期一)至7月14(星期五)，共10天，上午8時30分至下午4時30分。

(二)研習地點：明新科技大學逢喜樓209教室、明新科技大學半導體封裝測試類產線基地。

(三)參加培訓人數30人(名額有限滿額為止)。

三、報名方式：

(一)報名時間：112年6月25日截止

(二)報名網址：<https://forms.gle/4hipgy9nkyBj5VYs5>

四、報名洽詢：明新科技大學半導體學院類產線計畫辦公室何宗穎助理，電話：(03)5593142分機3270

正本：各公私立高級職業學校、各公私立大專校院

副本：本校半導體學院、產學及技術移轉中心